

深圳市江波龙电子股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-010

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中泰证券、申万证券、天风证券、交银施罗德、中银基金、人保资产、旺旺投资、汇丰晋信、南方基金、博时基金、中邮基金、兴全基金、富国基金、太平养老、嘉实基金、博裕资本、天弘基金、安信基金、太平资产、国投瑞银
时间	2024年7月23日(周二) 上午 11:00~12:00 2024年7月24日(周三) 下午 15:00~16:30 2024年7月24日(周三) 下午 16:30~17:30
地点	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2301
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 许刚翎 投资者关系经理 黄琦 投资者关系资深主管 苏阳春

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>1、从业绩预告来看，公司二季度净利润有所下滑，其具体原因？</b></p> <p>答：公司作为国内领先的综合型半导体品牌存储企业，各项经营指标与行业发展趋势保持一致。公司高度重视创新激励与研发建设，在高端企业级存储器、工规级存储器、自研主控芯片、自研存储芯片、高端封测制造等核心能力上保持投入，2024年半年度研发费用相比于2023年同期保持高速增长。具体财务数据，请您关注公司后续披露的相关公告。</p> <p><b>2、公司二季度毛利率情况？</b></p> <p>答：从市场经验来看，二季度后半段通常处于存储市场的淡季，应用于消费电子终端市场的嵌入式业务略有承压，但公司毛利率等核心指标仍然保持行业趋势和行业竞争力。另外，公司研发投入保持着高速增长，研发费用一般会对净利润表现有所影响。具体毛利率情况请关注公司后续披露的相关公告。</p> <p><b>3、如何看待下半年的市场走势？</b></p> <p>答：展望下半年，公司认为各个细分领域的结构性分化情况会逐步明显，在消费类电子的应用场景中，上下游之间的供需将有所博弈，值得观察。企业级服务器存储，工规级及车规级等中高端存储市场的情况更为乐观一些，公司将充分利用其结构性短缺以及价格接受度较高的情况，将中高端存储业务经营得更好，更稳。</p> <p>同时，随着存储价格涨幅逐步趋于平稳，未来各厂商之间的技术能力、市场能力及品牌能力等差异化要素的作用权重有望增大。</p> <p><b>4、公司自研小容量存储业务进展？</b></p> <p>答：公司 SLC NAND Flash 存储芯片主要应用包括汽车、安防、穿戴、IOT、家用电器、网通、工业自动化等各</p>
---------------------------	--

个应用领域，累计出货量已超过 5000 万颗。目前公司与这些主要应用领域的头部客户都已经建立了稳定的合作关系，与此同时还在国际穿戴品牌客户中取得了突破，成功导入了其旗舰产品。此外，在高可靠性的工业自动化、车载应用中公司也取得了 0 到 1 的突破。

2024 年 1 月，继自研 SLC NAND Flash 系列产品实现规模化量产后，江波龙发布首颗自研 32Gb 2D MLC NAND Flash，并于一季度完成流片验证。公司自研存储芯片业务的顺利推进，代表着公司具备了从存储晶圆设计、生产端深入理解各类存储晶圆特性的能力，除了能够更好地开展 SLC NAND Flash 小容量存储芯片业务之外，还能更好地反哺公司大容量存储业务，从而形成从小容量存储到大容量存储的体系化竞争优势。

#### **5、公司库存变化情况？**

答：公司采用以需求为基本牵引，结合市场综合因素判断的采购策略。随着公司整体销售规模的不断增长，公司存货金额相应增加。与此同时，因企业级存储晶圆的供应需保证一定的库存支撑，及公司大客户有所新增（如 OPPO 等），大客户非常关注公司持续供应能力，公司相应增加备货。随着备货战略目的的实现并结合现在的市场情况，公司将进一步加强存货管理，以及合理化存货金额。

#### **6、公司企业级存储业务进展及客户拓展情况？**

答：企业级存储与其他领域不同，其研发和验证周期较长，投入巨大。2020 年公司开始战略布局，启动产品研发。经过三年的努力，江波龙的企业级产品已拥有较为完整的产品线，其中企业级 SSD 和 RDIMM 产品从去年 Q4 开始已经在运营商、金融和互联网客户端实现规模交付并获得客户的认可并取得了极高的性能和质量评价。随着服务器，数据中心的资本投入升温，未来公司有望开拓更多客

户。

#### **7、公司主控芯片业务进展及对公司毛利率贡献情况？**

答：公司布局自研主在于提升存储产品综合竞争力，为大客户业务提供关键技术支持，助力公司中高端存储器产品固件算法自研的竞争优势体现，进一步增强公司整体竞争力以及产品技术护城河。公司两款自研主控芯片（WM 6000、WM 5000）已经批量出货，赋能公司 eMMC 和 SD 卡两大核心产品线，并已经实现了数千万颗的规模化产品导入。

从行业经验来看，具备自研主控芯片的境内外上市存储企业，其毛利率表现一般更为理想。作为行业规律，公司相信不断提升的自研主控芯片能力将直接及间接地，持续提升公司盈利能力。

#### **8、公司在 AI 领域的布局情况？**

答：随着 AI 的爆发，数据量呈指数级增长，对存储厂商提出更高的技术创新能力要求。公司基于自身产业能力，正在积极应对 AI 带来的机遇和挑战，在产品和技术研发方面进行全方位布局和投入，针对不同领域推出相应的创新产品，以满足多样化的市场要求。例如，针对 AI 手机、AI PC，推出 UFS、LPDDR 系列、LPCAMM2、PCIe BGA SSD 等高性能、低功耗、大容量的存储产品；针对服务器领域，推出 CXL2.0 内存拓展模块、RDIMM、eSSD 等满足 AI 服务器需求；针对智能座舱、自动驾驶应用，推出符合车规级别的 eMMC、UFS 等高可靠产品，以保障数据安全。

#### **9、公司 Lexar（雷克沙）品牌发展规划及展望？**

答：Lexar（雷克沙）作为全球领先的闪存品牌和 CF 高速存储卡读取标准的建立者，始终以创新思维打造领先业界的存储产品及解决方案。产品覆盖专业影像存储、移动存储、个人系统存储等领域，广泛满足全球消费者及企

业客户的各类存储需求。作为具有 28 年历史的国际高端消费类存储品牌，Lexar（雷克沙）多次获得红点设计大奖、美国 MUSE 设计奖、TIPA 最佳存储产品等众多国际大奖，Lexar（雷克沙）在国内、北美、欧洲、南美、中东、大洋洲等全球市场具有广泛品牌影响力。依据市场机构统计，Lexar（雷克沙）位列 2022 年全球 SSD 模组厂自有品牌出货市占率第三名；2023 年，其 SSD 产品线在美国、欧洲、中东等市场继续高速增长，并在波兰等全球“游戏高地”，成功冲击市场份额第一；此外，Lexar（雷克沙）还积极开拓拉美市场、中东非市场、澳洲市场，且取得了显著的突破。坚守创新和品质，同时为全球用户带来多元化、本土化的产品和服务，是 Lexar（雷克沙）全球持续增长的关键。未来，Lexar（雷克沙）将继续基于用户需求，充分发挥技术优势、人才优势、供应链优势，持续打造全球高端消费存储品牌，为全球用户带来更好的存储产品和服务。

#### **10、元成苏州及 Zilia 的未来发展规划？**

答：作为公司加强生产制造端布局的具体措施，元成苏州在继续承接现有客户群体的封测委托外发业务之外，还将进一步成为公司整体业务的封装测试基地，提高公司在封测和制造上的能力，满足客户交付保障的要求，其产能利用率将不断增长。Zilia 的收购作为公司加大海外市场开拓的具体举措，公司将以自身的技术与产品设计方案为 Zilia 赋能，发挥 Zilia 贴近本地客户、自研技术、综合存储产品、本地制造的优势，为海外客户提供更优质的服务，扩大公司的海外市场份额，并为公司国际业务的中长期发展起到基础性作用。

#### **11、公司未来是否会布局 HBM 业务？**

答：公司暂时没有实质性布局 HBM 业务的计划，也没

	<p>有发现行业内有除了存储原厂业务体系之外的任何独立第三方自行成功开展了 HBM 业务的先例。</p> <p>HBM 技术涉及到公司上游，即存储原厂内存芯片设计技术、晶圆级堆叠技术等不同环节的技术复合型应用。目前全球范围内的 HBM 产品技术应用均以存储晶圆原厂（如 SK Hynix，三星等）为主导甚至是存储原厂自行完成封装。目前公司子公司元成苏州具备晶圆高堆叠封装（HBM 技术涉及的一部分）的量产能力，但目前无法生产 HBM。</p>
附件清单（如有）	无